

### 主要特点

主要用于增益控制电路

工作频段：0.1 - 2 GHz

增益：28.5 dB@+5 V

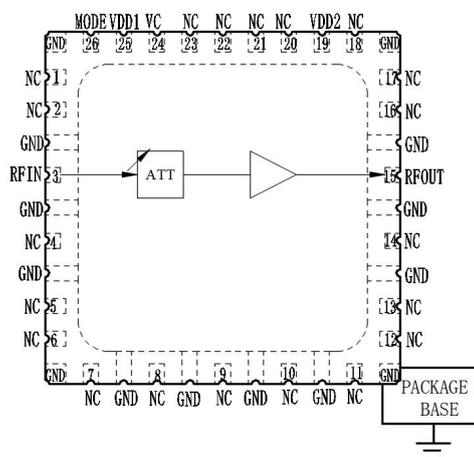
P1dB: +19 dBm@+5 V

衰减范围：0~30 dB

压控范围：0~5 V

陶封尺寸：26 Lead, 7mm × 7mm QFN

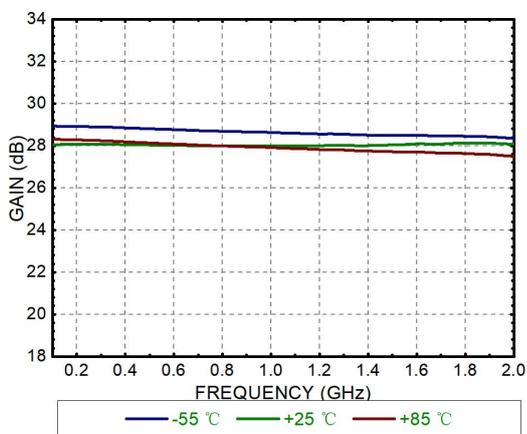
### 引脚示意图



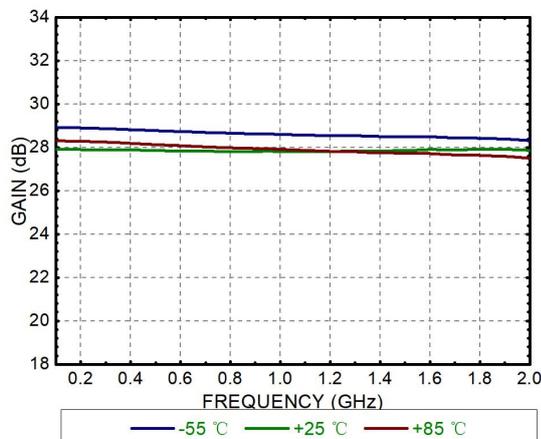
### 性能指标 ( $T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$ , $VDD1=VDD2=+5\text{V}$ )

参数	VDD1=VDD2=+5V			单位
	最小	典型	最大	
频率范围	0.1-2			GHz
增益		28.5		dB
增益平坦度		$\pm 1.5$		dB
输入回波损耗		10		dB
输出回波损耗		14		dB
输出功率 1dB 压缩点		19		dBm
最大衰减量		30		dB
工作电流		95		mA

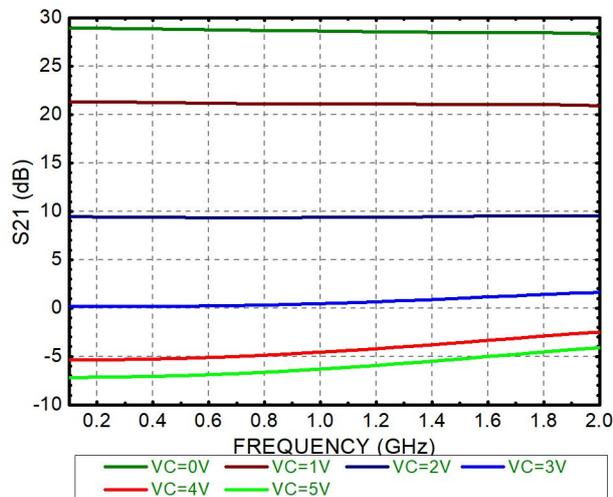
### 增益 Mode=0V 负斜率模式



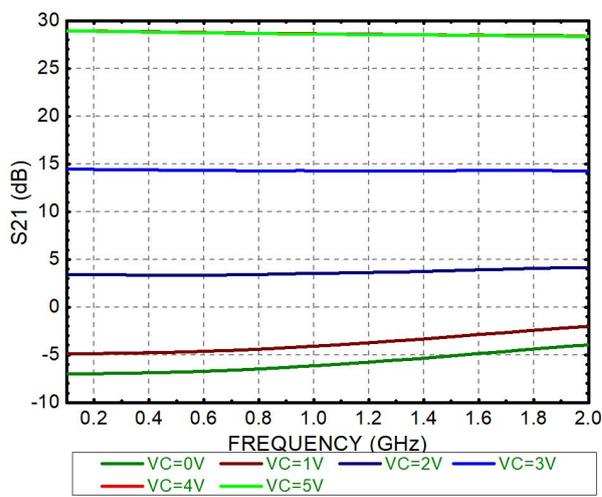
### 增益 Mode=5V 正斜率模式



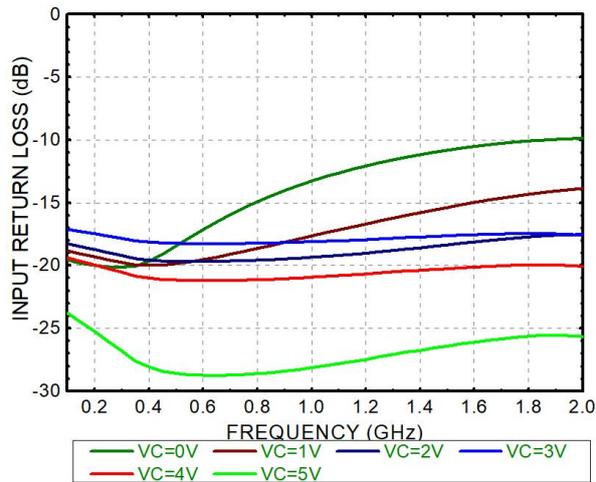
Mode=0V 负斜率模式, Temp=25°C



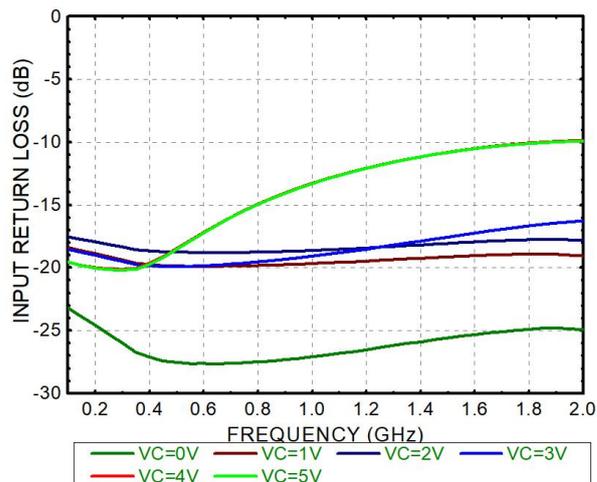
Mode=5V 正斜率模式, Temp=25°C



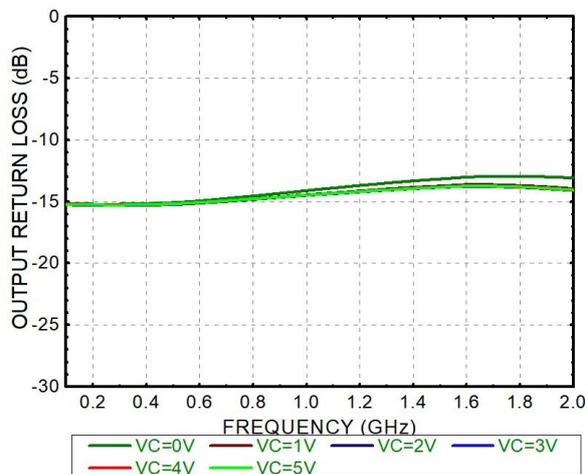
输入回波损耗, Mode=0V, Temp=25°C



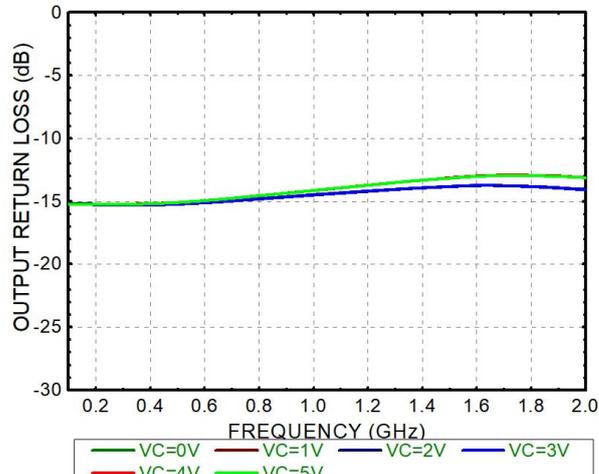
输入回波损耗, Mode=5V, Temp=25°C



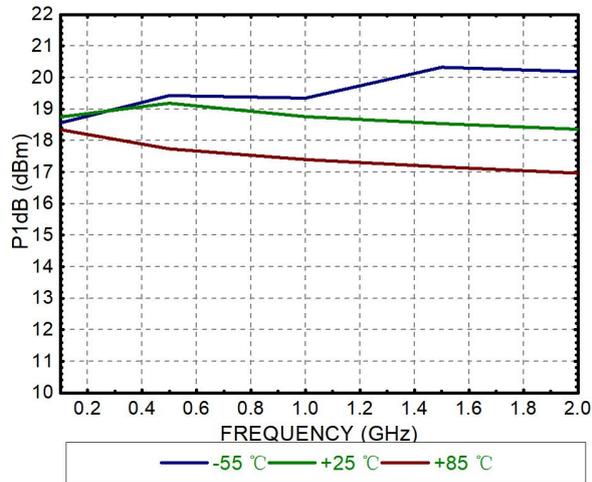
输出回波损耗, Mode=0V, Temp=25°C



输出回波损耗, Mode=5V, Temp=25°C

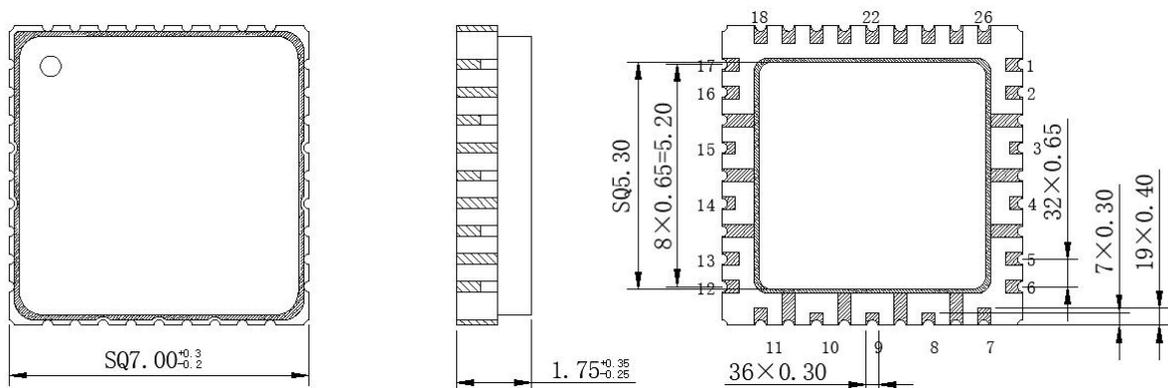


输出功率P1dB Mode=0V



物理参数

单位: mm



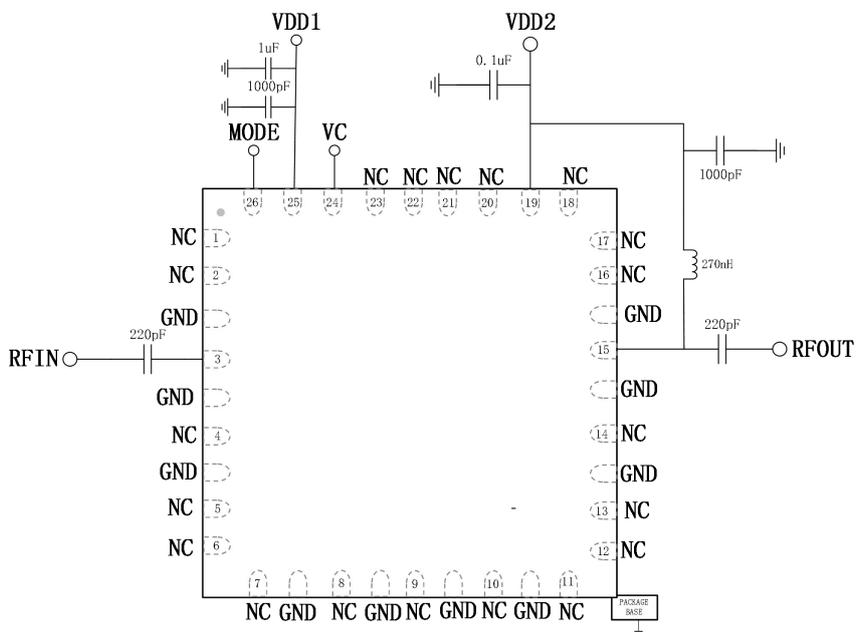
注意事项:

- 1、 器件在干燥、氮气环境中存储;
- 2、 器件对静电敏感, 在储存、运输、装配和使用过程中注意防静电;
- 3、 所有接地引脚请连接RF/DC地;
- 4、 该产品适用于回流焊安装工艺, 回流焊温度 $\leq 265^{\circ}\text{C}$ , 建议焊料融化时间 $\leq 3$ 分钟, 回流焊使用时需要做去金预处理。

### 引脚描述

引脚序号	功能	描述
3	RFIN	该引脚是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
15	RFOUT	该引脚是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm，外接偏置电路
19	VDD2	+5V 电源，需外接 0.1uF 去耦电容
24	VC	压控输入 (0~5V)
25	VDD1	+5V 电源，需外接 1000pF 和 1uF 去耦电容
26	MODE	正负压控斜率模式选择 (负斜率 MODE =0V, 正斜率 MODE =5V)
其余	NC	接地或者悬空
GND 引脚及底部中央焊盘	GND	GND 引脚及底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地

### 推荐装配图



### 极限参数

1. 电源电压: +5.5 V
2. 射频输入功率: +30 dBm
3. 储存温度: -55 ~ +125 °C
4. 工作温度: -55 ~ +85 °C